

【附件二：個資同意書】

受理編號：

個人資料蒐集、處理及利用之告知暨同意書

告知事項

財團法人工業技術研究院（工研院）及 CMP Products Limited（CMP）為了蒐集、處理及利用基於 CMP Products 爆炸性環境電纜接頭組裝訓練，您所提供或未來基於各種事由提供的個人資料（下稱個資），謹先告知下列事項：

- 一、蒐集目的：「○七八 計畫、管制考核與其他研考管理」、「一〇三 專門職業及技術人員之管理、懲戒與救濟」、「一〇九 教育或訓練行政」、「一一〇 產學合作」。
- 二、個資類別：姓名、性別、生日、身分證統一編號、相片、電子簽章、任職公司及職稱、電話號碼、通訊地址、傳真、E-mail、專長專業資格、學經等辨識個人、個人描述、職業及資格等個資。
- 三、利用期間：至蒐集目的消失為止。
- 四、利用地區：中華民國、新加坡/英國地區。
- 五、利用者：工研院、CMP 及其他與工研院及 CMP 有業務往來之公務及非公務機關。
- 六、利用方式：在不違反蒐集目的的前提下，以網際網路、電子郵件、書面、傳真及其他合法方式利用之。
- 七、您得以書面主張下列權利：

- （一）查詢或請求閱覽。
- （二）請求製給複製本。
- （三）請求補充或更正。
- （四）請求停止蒐集、處理或利用。
- （五）請求刪除。

若有上述需求，請與工研院承辦人員劉小姐(電話：03-5916357；E-mail：shengtsz@itri.org.tw)聯繫，工研院將依法進行回覆。

八、您若不簽署本告知暨同意書，工研院及 CMP 可能無法對您提供完整的服務，亦可能無法維護您的權益。

九、對工研院及 CMP 所持有您的個資，工研院及 CMP 會按照政府相關法規保密並予以妥善保管。

個資非由當事人本人提供者，請蒐集單位填寫個資來源：_____在此種情形，本告知事項之對象仍為上述個資之本人。

財團法人工業技術研究院
代理人：

姓名：張培仁
職稱：院長

CMP Products Limited
代理人：

姓名：Chong Puey Nee
職稱：Regional Manager

同意事項

本人已閱讀並瞭解上述告知事項，並同意工研院及 CMP 在符合上述告知事項範圍內，蒐集、處理及利用本人的個資。

當事人：

姓名：
住所：
身分證統一編號：

中華民國 115 年 月 日